

2019年中国驱动IC用COF市场分析报告- 行业竞争现状与发展前景预测

报告大纲

一、报告简介

观研报告网发布的《2019年中国驱动IC用COF市场分析报告-行业竞争现状与发展前景预测》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：<https://baogao.chinabaogao.com/dianzidiangong/402882402882.html>

报告价格：电子版: 7200元 纸介版：7200元 电子和纸介版: 7500

订购电话: 400-007-6266 010-86223221

电子邮箱: sales@chinabaogao.com

联系人：客服

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，页面图表可能存在缺失；格式美观性可能有欠缺，实际报告排版规则、美观；可联系客服索取更完整的目录大纲。

二、报告目录及图表目录

【报告大纲】

第一章 COF产品概述

第一节 COF的定义

第二节 COF品种

第三节 COF——目前的主流挠性IC封装形式

一、IC封装

二、IC封装基板与常规印制电路板在性能、功能上的差异

三、IC封装基板的种类

第四节 COF与TAB、TCP、TAPE BGA/CSP在定义上的区别

第五节 COF在驱动IC中的应用

第六节 COF行业与市场发展概述

第二章 COF的结构及其特性

第一节 COF的结构特点

第二节 COF在LCD驱动IC应用中的特性

第三节 COF与其它IC驱动IC封装形式的应用特性对比

一、COF与COG比较

二、COF与TAB比较

第四节 未来COF在结构及其特性上的趋势预测

一、制作线宽/线距小于30 μ M的精细线路封装基板

二、卷式（ROLL TO ROLL）生产方式的发展

三、多芯片组装（MCM）形式的COF

第五节 COF的更高阶封装形式——基于挠性基板的3D封装的发展

一、从2D发展到3D的挠性基板封装

二、基于挠性基板的3D 封装的主要形式

第三章 驱动IC产业现状与发展

第一节 驱动IC的功能与结构

一、驱动IC的功能及与COF的关系

1、驱动IC的功能

2、驱动IC与COF的关系

二、驱动IC的结构

三、驱动IC的品种

第二节 驱动IC在发展LCD中具有重要的地位

第三节 大尺寸TFT-LCD驱动及其特点

一、大尺寸TFT-LCD驱动特点

二、大尺寸TFT-LCD驱动芯片设计难点

第四节 驱动IC产业的特点

第五节 世界显示驱动IC的市场现况

一、显示驱动IC制造厂商与下游LCD面板厂家的关系及分析

二、世界显示驱动IC设计业现况

三、世界显示驱动IC市场规模调查统计

第六节 世界显示驱动IC主要生产厂家的现况

第四章 液晶面板应用市场现状与发展

第一节 世界液晶面板市场规模与生产情况概述

一、世界液晶面板市场变化

二、世界面板市场品种的格局

三、台、中、日、韩面板产业发展及趋势分析

第二节 世界大尺寸TFT-LCD应用市场发展现况

一、世界大尺寸面板市场规模总述

二、液晶电视领域对大尺寸面板的需求情况

三、平板电脑领域对大尺寸面板的需求情况

四、显示器领域对大尺寸面板的需求情况

五、对2018年世界大尺寸面板市场需求的预测

第三节 我国液晶面板市场规模与生产情况概述

一、我国驱动IC设计行业的情况

二、我国液晶面板产业的发展

三、我国液晶面板生产现况与未来几年发展预测

第五章 COF的生产工艺及技术的发展

第一节 COF制造技术总述

一、COF的问世

二、COF的技术构成

第二节 COF挠性基板的生产工艺技术

一、COF挠性基板生产的工艺过程总述及工艺特点

二、挠性基板材料的选择

三、精细线路的制作

第三节 IC芯片的安装技术

第四节 COF挠性基板的主要性能指标

第六章 世界COF基板的生产现状

第一节 全世界COF基板生产量统计

第二节 全世界COF市场格局

第三节 全世界COF基板主要生产厂家的

第四节 全世界COF基板主要生产情况

一、日本COF基板厂家

二、韩国COF基板厂家

1、韩国LG MICRON

2、韩国STEMCO

三、台湾COF基板厂家

1、台湾欣邦

2、台湾易华

第七章 我国COF基板的生产现状

第一节 我国FPC业的现状

第二节 我国COF的生产现状

第三节 我国COF基板的生产企业现状

一、国内COF基板生产企业发展概述

二、深圳丹邦科技股份有限公司

1、企业概况

2、COF相关产业发展概况

3、企业经营情况

4、核心优势及投资前景

三、三德冠精密电路科技有限公司

1、企业概况

2、COF相关产业发展概况

3、企业经营情况

4、核心优势及投资前景

四、上达电子（深圳）股份有限公司

1、企业概况

2、COF产业发展概况

3、企业经营情况

4、核心优势及投资前景

五、厦门弘信电子科技股份有限公司

1、企业概况

2、COF产业发展概况

3、企业经营情况

4、核心优势及投资前景

第八章 COF挠性基板用二层型挠性覆铜板特性与生产现状

第一节 二层型挠性覆铜板品种及特性

第二节 挠性覆铜板产品主要采用的标准及性能要求

一、适用于FCCL的中国国家标准介绍

二、国际上广泛使用的FCCL标准介绍

1、IPC标准

2、IEC标准

3、日本标准

4、测试方法比较

三、实际产品应用中的性能要求

第三节 挠性覆铜板的生产工艺

一、三层型挠性覆铜板的生产工艺

1、片状制造法

2、卷状制造法

二、二层型挠性覆铜板的生产工艺

1、涂布法 (CASTING)

2、层压法 (LAMINATION)

3、溅镀法 (SPUTTERING/PLATING)

第四节 世界挠性覆铜板生产现状及主要生产厂家

一、总述

二、日本FCCL业生产现状与发展

三、美国、欧洲FCCL业的现状与发展

四、台湾FCCL业的现状与发展

五、韩国FCCL业的现状与发展

第五节 我国国内挠性覆铜板生产现状及主要生产厂家

一、我国国内挠性覆铜板业发展总述

二、我国国内挠性覆铜板生产厂家现况

图表目录：

图表 1：三种封装基板的CTE及对CCL的CTE要求

图表 2：COF与COG比较分析

图表 3：COF与TAB比较分析

图表 4：2015-2018年世界显示驱动IC市场规模调查统计

图表 5：世界显示驱动IC主要生产厂家分析

图表详见报告正文.....（GY YX）

【简介】

中国报告网是观研天下集团旗下打造的业内资深行业分析报告、市场深度调研报告提供商与综合行业信息门户。《2019年中国驱动IC用COF市场分析报告-行业竞争现状与发展前景预测》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

它是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势，洞悉行业竞争格局，规避经营和投资风险，制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一。本报告是全面了解行业以及对本行业进行投资不可或缺的重要工具。观研天下是国内知名的行业信息咨询机构，拥有资深的专家团队，多年来已经为上万家企业单位、咨询机构、金融机构、行业协会、个人投资者等提供了专业的行业分析报告，客户涵盖了华为、中国石油、中国电信、中国建筑、惠普、迪士尼等国内外行业领先企业，并得到了客户的广泛认可。

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国家统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。本研究报告采用的行业分析方法包括波特五力模型分析法、SWOT分析法、PEST分析法，对行业进行全面的内外部环境分析，同时通过资深分析师对目前国家经济形势的走势以及市场发展趋势和当前行业热点分析，预测行业未来的发展方向、新兴热点、市场空间、技术趋势以及未来发展战略等。

详细请访问：<https://baogao.chinabaogao.com/dianzidiangong/402882402882.html>